

TECHNISCHES DATENBLATT**HOCHTEMPERATUR-SILICON (3057)**

HOCHTEMPERATURSILICON – ACETAT-SYSTEM

ANWENDUNGSBEREICH:

- HOCHTEMPERATUR-SILICON** eignet sich für Anschluß- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich
- speziell für Verfügen im Hochtemperaturbereich
 - im Heizungsbau, Lüftungsbau, im Apparatebau und in der Automobilindustrie
 - Industrie, Handwerk und Hobby

EIGENSCHAFTEN/HAFTUNG:

HOCHTEMPERATUR-SILICON ist speziell für hohe Temperaturen bis + 250 °C entwickelt, vulkanisiert durch Einfluß von Luftfeuchtigkeit zu einem außerordentlich beständigen, geruchlosen und elastischen Material und ist normal entflammbar nach DIN 4102, Teil I.

TECHNISCHE ANGABEN:

Basis:	Silikonkautschuk, einkomponentig
Härtungssystem:	sauer-Acetat
Standvermögen: (DIN 52452-ST-U 26 - 23)	Standfest < 2 mm
Spez. Gewicht: (DIN 52451-PY)	Ca. 1,08 g/cm ³
Hautbildungszeit: (23 °C / 50 % r. F.)	Ca. 12 Minuten
Shore-A-Härte: (DIN 53505, 4 Wochen 23 °C / 50 % r. F.)	Ca. 28
Volumenänderung: (DIN 52451-PY)	Ca. - 3 %
Dehn- und Spannungswert bei 100%: (DIN 52455 NWT-I-A2-I00-23)	Ca. 0,8 N/mm ²
Maximale Bewegungsaufnahme in der Praxis:	Ca. 25 %
Temperaturbeständigkeit:	Ca. - 40 °C bis + 250 °C (nach der Vulkanisation); kurzzeitig auch über + 300 °C
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C (Untergrundtemperatur)
Lagerfähigkeit:	12 Monate bei trockener, kühler Lagerung

FUGENMASSE, HINTERFÜLLUNG:

Bei Fugenbreiten von 5 - 10 mm soll der Fugenquerschnitt quadratisch sein. Fugenbreiten von 10 - 20 mm erfordern eine Mindestdiefe von 10 mm. Bei Fugen über 20 mm Breite soll die Fugentiefe die Hälfte der Fugenbreite betragen. Die Fugen müssen mit einem geeigneten Schaumstoffband vorgefüllt werden.

VORBEREITUNG DER HAFTFLÄCHEN:

Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken und frei von Schmutz, Staub und Fremdstoffen sein. Öl- und Fettrückstände sind zu entfernen. Geeignete Reinigungsmittel **BOSTIK Solvent 250** oder **BOSTIK Solvent 300**. Fugenränder mit Selbstklebeband abdecken.

VERARBEITUNG:

HOCHTEMPERATUR-SILICON mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig und ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden. Oberfläche anschließend sofort mit einem angefeuchteten Spachtel, Fugeisen oder anderem geeigneten Werkzeug (spülmittelhaltiges Wasser, ca. 1-2%ig) glätten, Klebeband abziehen. Angebrochene Kartuschen möglichst bald verbrauchen.

REINIGUNG:

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit **BOSTIK Solvent 250** oder **BOSTIK Solvent 300** entfernen. Im abgeordneten Zustand ist **HOCHTEMPERATUR-SILICON** nur noch mechanisch zu entfernen.

BESONDERE HINWEISE:

Bei einigen Metallen, z. B. Blei, Eisen, Stahl, Kupfer, besteht durch Einwirkung von Essigsäure Korrosionsgefahr. Es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

VERBRAUCH:

Bei 10 x 10 mm Fugenquerschnitt reicht die Kartusche für ca. 3 lfdm. Der Verbrauch läßt sich durch Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = cm² pro lfdm. Fuge errechnen.

LIEFERGEBINDE:

rot Artikel-Nr. 50-4246 003 I 20 x 300 ml Kartusche

Weitere Auskünfte gibt unser Sicherheitsdatenblatt.



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 07. 09